附件1

济南市集成电路产业集聚区申报书

集 聚 区 名 称

申报单位（盖章）

推荐单位（盖章）

申 报 日 期 20 年 月

填 写 说 明

一、正文字体为3号仿宋体，单倍行距。一级标题3号黑体，二级标题3号楷体，表格部分用4号仿宋体填写。

二、申报书用A4纸双面打印编辑目录后胶装成册，左侧装订，加盖骑缝章。

三、申报材料（含真实性承诺）需加盖申报单位公章。

信用承诺书

本单位（公司）自愿申报济南市集成电路产业集聚区，并就如下事项做出承诺：

一、本单位（公司）所填报和提交的全部资料真实有效、事实存在。

二、本单位（公司）所填报的知识产权证书（专利、集成电路布图证书）明晰完整，正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人知识产权。

三、近三年未发生重大安全、质量和环境污染责任事故。

四、纳税和信用状况良好，无违法和不良信用记录。

若发生与上述承诺相违背的事实，由本单位（公司）承担法律责任。

法定代表人：（签字）

申报单位：（盖章）

2024年 月 日

一、集聚区投资或管理机构基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 人员数量（人） |  | 通讯地址 |  |
| 物业情况（是否自有物业、租赁起始时间等） |  |
| 单位性质 | 🞎 企业 🞎 事业单位 |
| 机构基本情况简介 | （包括但不限于硬件、软件设施配套情况，场地情况，企业服务保障情况、配套服务措施情况） |

二、集聚区已入驻和意向入驻企业清单

已入驻企业清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业简介 | 2023年主营业务收入（万元） | 使用建筑面积（平方米） | 签订入驻协议合同情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

已入驻企业需提供入驻协议或合同

意向入驻企业清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业简介 | 2023年主营业务收入（万元） | 拟使用建筑面积（平方米） | 计划签订入驻合同时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

三、相关情况详细介绍

1.集聚区基础设施和公共服务设施建设规划及投资概算说明。

2.集成电路公共技术服务平台建设及公共技术服务情况。（含集聚区集成电路公共技术服务设施建设规划及投资概算说明，如采用第三方合作方式提供公共技术服务的，需提供相关合作协议书）

3.产业规划、建设规划。（需经区主管部门出具审核意见并盖章）

四、证明材料

1.集聚区管理机构的企业营业执照副本或事业单位法人证书。

2.法定代表人身份证复印件。

3.集聚区自有物业房地产权证或租赁合同。

4.集聚区内企业技术中心、工程研究中心或研发机构，以及有效发明专利、集成电路布图登记证书等相关证明材料。

5.其他证明材料。